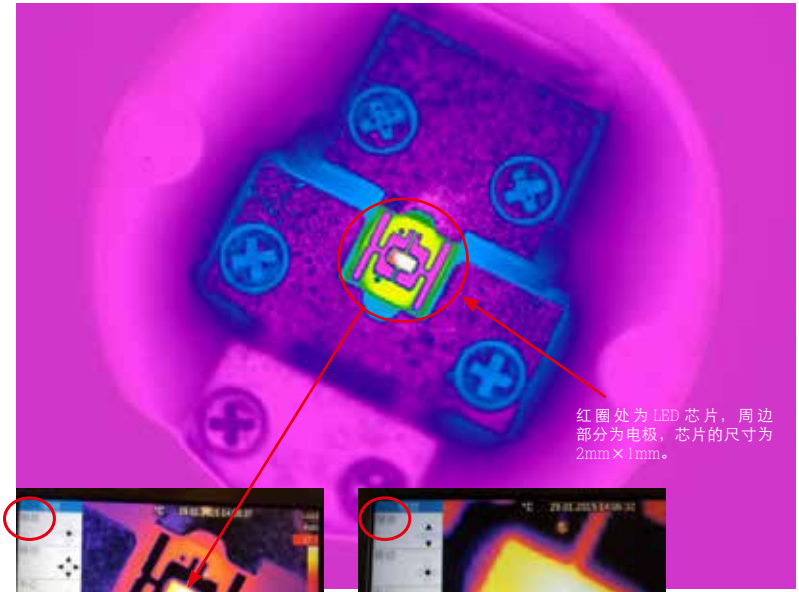
1 毫米芯片热分析



使用缩放功能在热像仪显示屏上对芯片进行 4 倍放大

对芯片进行 16 倍放大

从热像画面可清晰看出，芯片的左右侧温度不均匀，研发人员可以此为能依据，改进器件材料和散热设计。

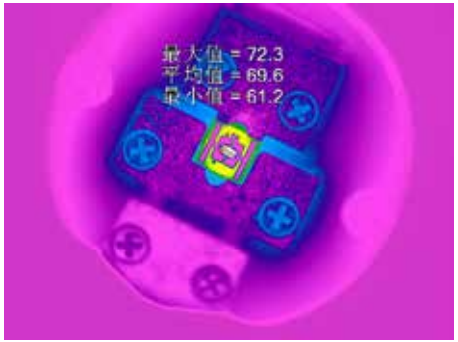
温度是 LED 芯片的核心技术指标，其代表着 LED 器件的设计水平，发热和散热情况直接影响 LED 产品的寿命和颜色质量，但由于 LED 芯片非常之小，传统检测方式无法进行测温。

检测案例：

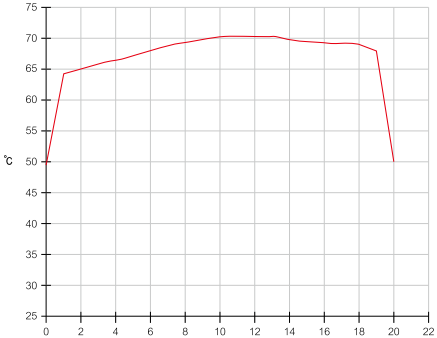
某知名光电器件制造商，在研发新产品中，需要对 LED 芯片的温度分布进行观测和分析，改善器件的发热和散热设计。

解决方案：

1、热像仪本机：TiX660 热像仪配套微距镜头 2。
2、安装三脚架和二维可调精密位移云台，部分现场需要热像仪垂直向下检测。
3、将热像仪手动调焦至“Near”框成红色，表示已完成最小目标的对焦。
4、细微调节精密位移云台，直至图像最为清晰。
5、在热像仪上对热图画面进行缩放，观测芯片的温度分布。
6、在 SmartView® 软件上对芯片的温度分布进行分析，并导出温度数据。

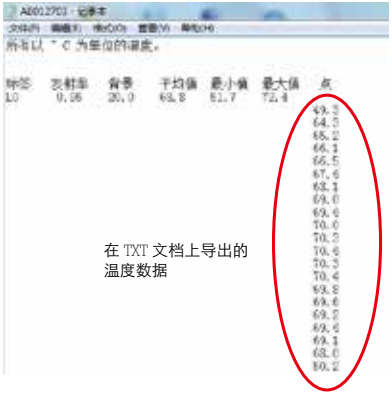


在软件上对芯片的进行线温度分析



随像素点位置变化的温度分布趋势图

专业三脚架（带液压阻尼功能）



拍摄机型：

Fluke TiX660 红外热像仪
配微距镜头 2

行业应用：

光电芯片器件、电子芯片器件制造商等。